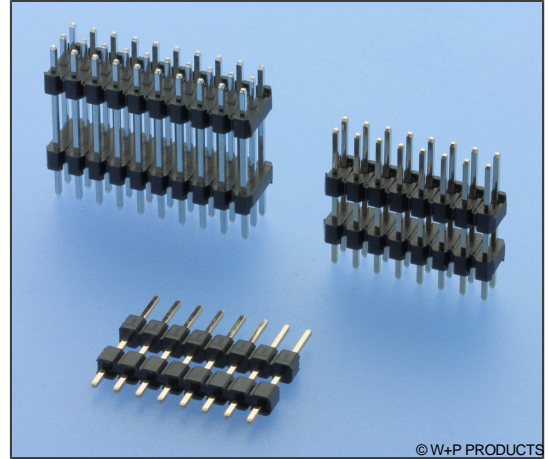


# 949 / 950 / 951

Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-/3-reihig  
Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, 1/2/3 Rows

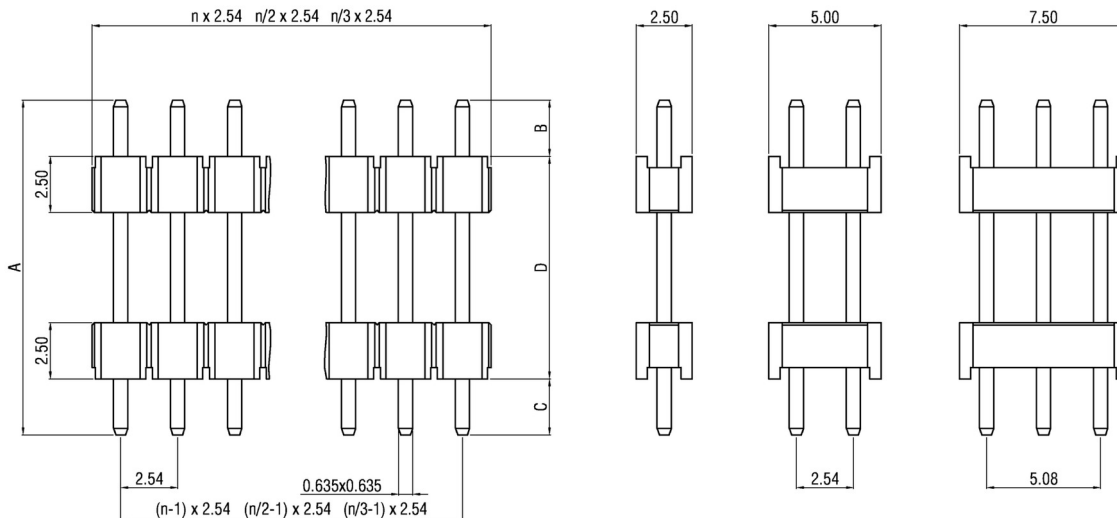
## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c <i>RoHS Exemptions 6a-I / 6c</i>	keine <i>none</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>&lt; 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>&gt; 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV DC <i>1 kV DC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC <i>250 V AC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A <i>3 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C <i>-40 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12  
*Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.*

### Series\*

**949**

Gestanzte/geprägte Kontakte  
*Stamped/formed contacts*  
949 Einreihig  
*Single row*  
950 Zweireihig  
*Double row*  
951 Dreireihig  
*Triple row*

### Dimensions\*

**19**

16 A=17,70 B=5,70 C=3,30 D=8,70mm  
17 A=19,80 B=5,70 C=3,30 D=10,80mm  
18 A=21,60 B=5,70 C=3,30 D=12,60mm  
19 A=22,80 B=5,70 C=3,30 D=13,80mm  
20 A=24,90 B=5,70 C=3,30 D=15,90mm  
21 A=26,70 B=5,70 C=3,30 D=17,70mm  
22 A=29,00 B=5,70 C=3,30 D=20,00mm  
23 A=30,80 B=5,70 C=3,30 D=21,80mm  
24 A=37,80 B=5,70 C=3,30 D=28,80mm  
25 A=40,80 B=5,70 C=3,30 D=31,80mm  
26 A=45,30 B=5,70 C=3,30 D=36,30mm  
*A/B/C/D Gesamtlänge & Wunschsmaße*  
*Total length & Dimensions*

### Contacts\*

**010**

001-050 Einreihig  
*Single row*  
004-100 Zweireihig  
*Double row*  
006-120 Dreireihig  
*Triple row*

### Plating\*

**00**

00 Au flash  
110 Sel. Au 0,25µm / flash  
130 Sel. Au 0,75µm / flash  
50 Sn  
66 Sel. Au flash / Sn  
610 Sel. Au 0,25µm / Sn  
80 Sel. Au 0,75µm / Sn  
Au flash <= 0,1µm  
Au flash <= 0,1µm

B, C, D nach Kundenwunsch variierbar. Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster auf Anfrage. Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter Techn. Informationen.

*B, C, D variable acc. to custom specifications. We will manufacture pin headers in the desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* *This is an order example - please replace by your specifications.*

wpro.com/serie/XXX  
wpro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
*Design and/or technical specifications may change without prior notice.*

**W+P** (+49) 5223 98507-0  
WE CONNECT IT sales@wpro.com

# Informationen zum Wellen-Lötverfahren

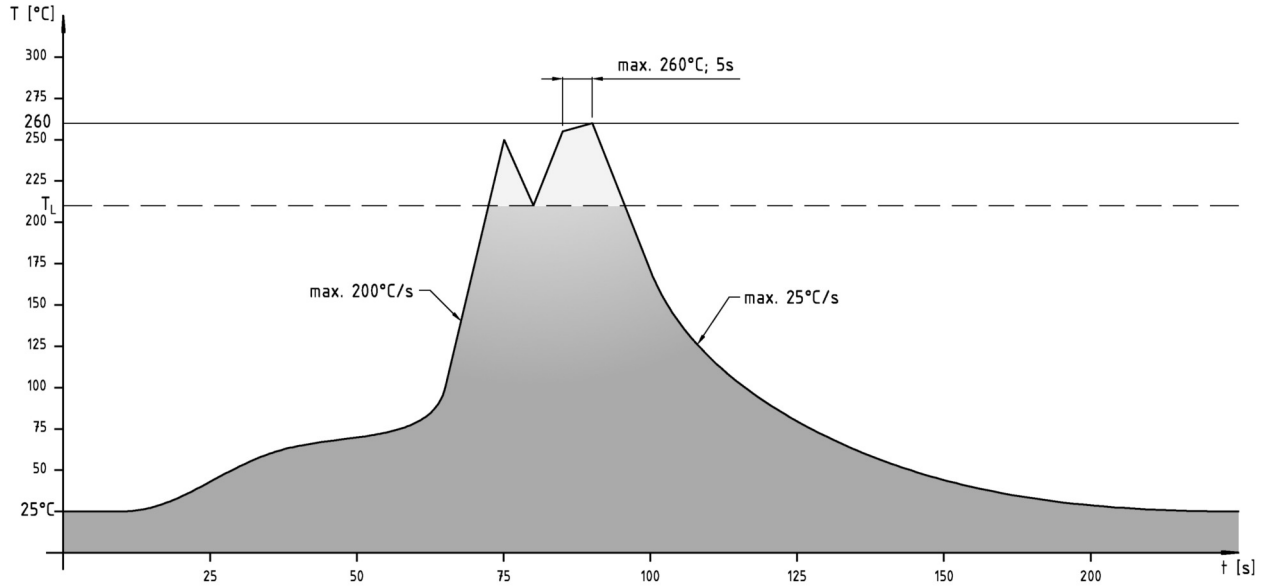
## Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

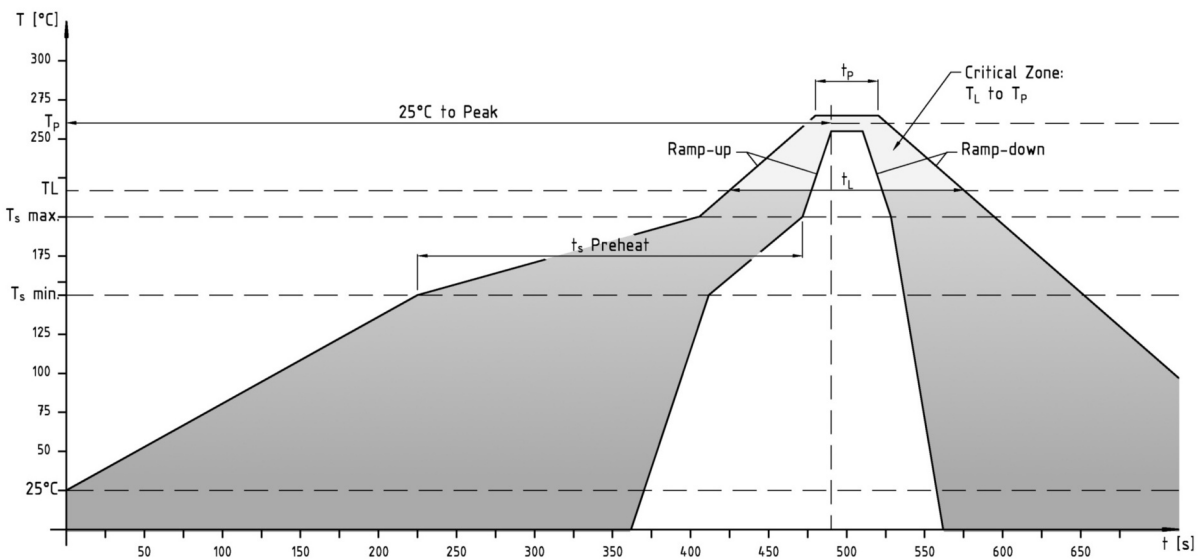
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

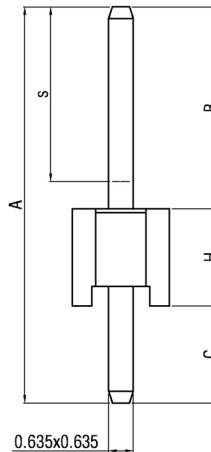
Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min



## Gerade Stiftheiten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

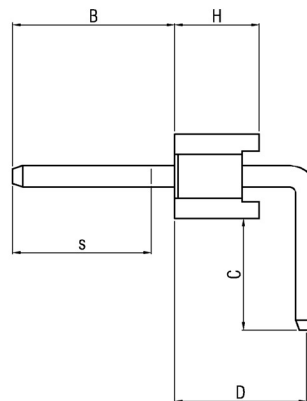
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



## Gewinkelte Stiftheiten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



## PCB Layouts

